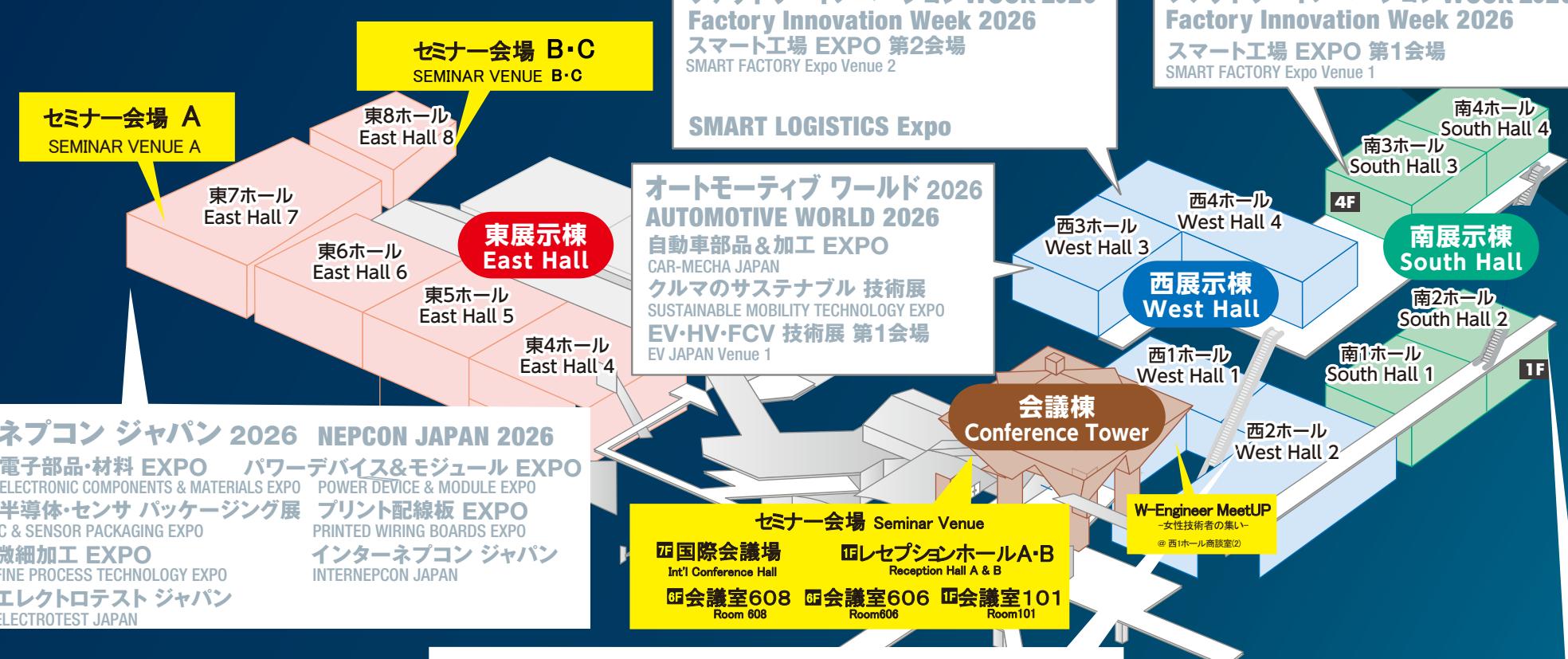


セミナー会場一覧

Seminar Venue MAP

マイページは
こちらから
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込は
こちらから
REGISTER NEW SESSION FROM HERE



<注意事項>

- 散会後、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- 一部テキスト配布を行わないセミナーもございます。あらかじめご了承ください。
- セミナーの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

[Caution]

- Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- Recording and photography are strictly prohibited.
- Speakers and programs are subject to change.
- Please be aware in advance that some seminars may not provide textbooks.

オートモーティブ ワールド 2026 AUTOMOTIVE WORLD 2026

国際カーエレクトロニクス技術展 CAR-ELE JAPAN

EV・HV・FCV 技術展 第2会場 EV JAPAN Venue 2

自動運転 EXPO AUTONOMOUS DRIVING TECHNOLOGY EXPO

SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展 SOFTWARE-DEFINED VEHICLE EXPO

コネクティッド・カー EXPO CONNECTED CAR JAPAN

ファクトリーイノベーションWeek Factory Innovation Week 2026

ロボデックス RoboDEX

製造業 人手不足対策 EXPO Manufacturing Industry's HR Expo

製造業カーボンニュートラル展 GREEN FACTORY Expo

1月21日[水] Wed. Jan. 21

セミナー・イベント スケジュール Seminar & Event Schedule

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
*Recording and photography are strictly prohibited.Speakers and programs are subject to change.Textbooks of some sessions are not available.

会議棟 Conference Tower			東展示棟 East Hall					西展示棟 West Hall			南展示棟 South Hall						
事前申込制 Pre-registration Required			事前申込制 Pre-registration Required					申込不要 No Application Required			申込不要 No Application Required						
国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL	会議室 606 CONFERENCE ROOM 606	会議室 608 CONFERENCE ROOM 608	レセプションホール B RECEPTION HALL B	会議室 101 CONFERENCE ROOM 101	セミナー会場 A SEMINAR VENUE A	セミナー会場 B SEMINAR VENUE B	セミナー会場 C SEMINAR VENUE C	パウェル アカデミックフォーラム Power Electronics Next -若手研究者フォーラム- Power Electronics Academic Forum / Power Electronics Net.-Early-Career Researchers' Forum	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場① Exhibitor's Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ①	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場② Exhibitor's Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ②	W-Engineer MeetUP -女性技術者の集い-	車載半導体 フォーラム In-vehicle Semiconductor Forum	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場③ Exhibitor's Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ③	アトリウム 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場④ Exhibitor's Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ④	中国車 徹底解説セミナー/新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場⑤ Exhibitor's Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ⑤	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~ 会場⑥ Exhibitor's Product/Technology Seminar ~New Tech Trend~ Venue ⑥	ヒューマノイドロボットショー Humanoid Robot Show
START														START			
10:00	10:00-10:50 AUTO-EV2 ジヤトココアフル開発戦略と実戦手技 JATCO's Core Development Strategy and Technical Solutions	10:00-11:00 FIW-S1 汎用ヒューマノイドロボット General Purpose Humanoid Robots	10:00-11:10 SLE-S1 運輸安全を学ぶ: 事故ゼロと安全文化が企業を強くする Transport Safety: How to Learn About Safety and Build a Strong Safety Culture	10:00-11:30 ISP-1 国内における次世代半導体パッケージ 最先端技術の発展と応用 Development Trends of Latest Manufacturing Technology and Applications of Packaging for Next Generation Semiconductors	10:00-11:30 PWB-1 AIで加速されるスマートフォンの最新市場/技術動向 Development Trends of Latest Manufacturing Technology and Applications of Packaging for Next Generation Semiconductors	10:00-11:10 NEPCON-S1 インダストリアルスマートフォンの台頭 ～IoTと世界のために～ Emergence of Industrial Smartphones in India and the World	10:00-11:40 PDM-F1 抜き、EMI、コストの3つを同時に低減するアクティブドライブ技術 Active Drive IC Simultaneously Reduces Loss, EMI, and Cost	10:11:40 PDM-F1 抜き、EMI、コストの3つを同時に低減するアクティブドライブ技術 Active Drive IC Simultaneously Reduces Loss, EMI, and Cost	11:00-11:30 DAICO-SK1 DAICO-SK1を活用した大丸興業のSDVソリューション DAICO-SK1 Utilization for Ochiai Kogyo's SDV Solution	11:00-11:30 AUTO-C1 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	11:00-11:30 AUTO-C1 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	11:00-11:30 DAICO-SK1 DAICO-SK1を活用した大丸興業のSDVソリューション DAICO-SK1 Utilization for Ochiai Kogyo's SDV Solution	11:00-11:30 AUTO-C1 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	11:00-11:30 AUTO-C1 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	11:00-11:30 AUTO-C1 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage		
11:00	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～	10:30-11:40 AUTO-K 運営時代の技術開発と価値づくり ～知能化の進度、取り組みと課題変化～ Driving Innovation is a Strategic Age Technology Development and Value Creation ～Intelligent Progress, Activities and Changes in Challenges～			
12:00	12:00-13:00 オートモーティブ ワールド エグゼクティブパーティ AUTOMOTIVE WORLD Executive Party	12:00-13:00 オートモーティブ ワールド エグゼクティブパーティ AUTOMOTIVE WORLD Executive Party	12:00-13:00 FIW-S2 電気自動車における電池のリアルと未来の姿 The Reality and Future of EVs Operations in Logistics Warehousing	12:00-13:00 FIW-S2 電気自動車における電池のリアルと未来の姿 The Reality and Future of EVs Operations in Logistics Warehousing	12:00-13:00 NEPCON-S2 「夢の紹介」 製造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか	12:00-13:00 ISR-2 2026年の電子デバイス産業は一気に飛躍する展開となってきた! The Electronic Device Industry Is Set to Make a Big Leap in 2026	12:00-14:00 PWB-2 6Gにおける次世代高速通信の材料開発および技術動向 Next-Generation High-Speed Application Development and Technical Trends	12:00-14:00 PDM-F2 6Gが導入するパワーデバイス Galaxy基盤技術が導入するパワーデバイス Galaxy Base Technology Drives Power Devices	12:00-14:00 PDM-F2 6Gが導入するパワーデバイス Galaxy基盤技術が導入するパワーデバイス Galaxy Base Technology Drives Power Devices	12:00-13:30 W9-48 温度計測によるサーモグラフィのメリットと注意点 Temperature Measurement by Thermographic Camera Temperature Measurement by Thermographic Camera	12:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	12:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	12:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	12:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	12:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	12:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	
13:00	12:30-14:00 AUTO-CN3 自動車メーカーが抱える 車体構造における最適化とは? Automotive View Automotive Body Manufacturing Technology Optimization of Vehicle Body Structure	12:30-13:40 SLE-S2 電気自動車施設における 電池のリアルと未来の姿 The Reality and Future of EVs Operations in Logistics Warehousing	12:30-13:40 FIW-S2 電気自動車における電池のリアルと未来の姿 The Reality and Future of EVs Operations in Logistics Warehousing	12:30-14:00 NEPCON-S2 「夢の紹介」 製造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか	12:30-14:00 ISR-2 2026年の電子デバイス産業は一気に飛躍する展開となってきた! The Electronic Device Industry Is Set to Make a Big Leap in 2026	12:30-14:00 PWB-2 6Gにおける次世代高速通信の材料開発および技術動向 Next-Generation High-Speed Application Development and Technical Trends	12:30-14:00 PDM-F2 6Gが導入するパワーデバイス Galaxy基盤技術が導入するパワーデバイス Galaxy Base Technology Drives Power Devices	12:30-14:00 PDM-F2 6Gが導入するパワーデバイス Galaxy基盤技術が導入するパワーデバイス Galaxy Base Technology Drives Power Devices	13:00-13:30 W9-48 温度計測によるサーモグラフィのメリットと注意点 Temperature Measurement by Thermographic Camera Temperature Measurement by Thermographic Camera	13:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	13:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	13:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	13:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	13:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services	13:00-13:30 W9-48 車載向け半導体/材料の 放熱性と信頼性評価サービスの紹介 Introduction to Thermal and Reliability Evaluation Services		
14:00	14:00-15:00 AUTO-CN5 自動車のカーボンニュートラル/ サーキュラーエコノミー実現に向けた取り組み in the Automotive Industry	15:00-16:10 FIW-S3 コトコトはなぜ利益生むGX: 最先端企業の事例紹介 How Cost-Effective Companies Are Achieving Successful Green Transformation	14:00-15:00 ISR-2 2026年の電子デバイス産業は一気に飛躍する展開となってきた! The Electronic Device Industry Is Set to Make a Big Leap in 2026	14:00-15:00 PWB-2 6Gにおける次世代高速通信の材料開発および技術動向 Next-Generation High-Speed Application Development and Technical Trends	14:00-15:00 PDM-F3 パワー半導体動向と活用法 カーボンニュートラルのグローバルプラットフォーム Power Semiconductor Development History and the Future Carbon Neutral Global Platform of Rethink	14:00-15:00 WEMUP-S1 マイクロチップ構造が実現する 半導体分野の新たなマネジメント Microchip Structure Realization Thermal Management	14:00-15:00 AUTO-F3 ボッシュのSiC/パワーセミコンダクタについて SC Power Semiconductors from Bosch	14:00-15:30 W2-8 NACS 高電圧・大容量充電とAIによる自動充電 High-power charging and AI automatic charging	14:00-15:30 W2-8 AIを活用した車両管理の最新動向 世界最大#1のGEOTABが開拓する So-DeV - AIを活用した車両管理の最新動向 世界最大#1のGEOTABが開拓する So-DeV -	14:00-15:30 AUTO-C2 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	14:00-15:30 AUTO-C2 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	14:00-15:30 AUTO-C2 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	14:00-15:30 AUTO-C2 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	14:00-15:30 AUTO-C2 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage	14:00-15:30 AUTO-C2 中国自動車メーカーに学ぶ車載RFID技術革新 Lessons from Chinese Automakers Technology, Speed & Cost Advantage		
15:00	15:00-16:10 AUTO-CN5 自動車のカーボンニュートラル/ サーキュラーエコノミー実現に向けた取り組み in the Automotive Industry	15:00-16:10 FIW-S3 コトコトはなぜ利益生むGX: 最先端企業の事例紹介 How Cost-Effective Companies Are Achieving Successful Green Transformation	15:00-16:10 NEPCON-S2 「夢の紹介」 製造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか	15:00-16:30 ISR-2 2026年の電子デバイス産業は一気に飛躍する展開となってきた! The Electronic Device Industry Is Set to Make a Big Leap in 2026	15:00-16:30 PWB-2 6Gにおける次世代高速通信の材料開発および技術動向 Next-Generation High-Speed Application Development and Technical Trends	15:00-16:30 PDM-F3 パワー半導体動向と活用法 カーボンニュートラルのグローバルプラットフォーム Power Semiconductor Development History and the Future Carbon Neutral Global Platform of Rethink	15:00-16:30 WEMUP-S1 マイクロチップ構造が実現する 半導体分野の新たなマネジメント Microchip Structure Realization Thermal Management	15:00-15:40 AUTO-F3 ボッシュのSiC/パワーセミコンダクタについて SC Power Semiconductors from Bosch	15:00-15:40 AUTO-F3 ボッシュのSiC/パワーセミコンダクタについて SC Power Semiconductors from Bosch								
16:00	16:00-17:00 FIW-S3 コトコトはなぜ利益生むGX: 最先端企業の事例紹介 How Cost-Effective Companies Are Achieving Successful Green Transformation	16:00-17:00 FIW-S3 コトコトはなぜ利益生むGX: 最先端企業の事例紹介 How Cost-Effective Companies Are Achieving Successful Green Transformation	16:00-17:00 NEPCON-S2 「夢の紹介」 製造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか 【業界紹介】 制造業の人手不足を デジタルでどのように解決するか	16:00-17:00 ISR-2 2026年の電子デバイス産業は一気に飛躍する展開となってきた! The Electronic Device Industry Is Set to Make a Big Leap in 2026	16:00-17:00 PWB-2 6Gにおける次世代高速通信の材料開発および技術動向 Next-Generation High-Speed Application Development and Technical Trends	16:00-17:00 PDM-F3 パワー半導体動向と活用法 カーボンニュートラルのグローバルプラットフォーム Power Semiconductor Development History and the Future Carbon Neutral Global Platform of Rethink	16:00-17:00 WEMUP-S1 マイクロチップ構造が実現する 半導体分野の新たなマネジメント Microchip Structure Realization Thermal Management	16:00-17:00 AUTO-F3 ボッシュのSiC/パワーセミコンダクタについて SC Power Semiconductors from Bosch	16:00-17:00 AUTO-F3 ボッシュのSiC/パワーセミコンダクタについて SC Power Semiconductors from Bosch								
17:00																	

会場全体／併催イベント マップ上の番号



1月22日[木]

Thu. Jan. 22

セミナー・イベント スケジュール Seminar & Event Schedule

* 敬称略。セッションの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合もございます。あらかじめご了承ください。
* Recording and photography are strictly prohibited. Speakers and programs are subject to change. Textbooks of some sessions are not available.

会議棟

東展示棟

西展示棟

南展示棟

事前申込制 Pre-registration Required

事前申込制 Pre-registration Required

申込不要 No Application Required

申込不要 No Application Required

申込不要 No Application Required

START

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

START

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL	会議室 606 CONFERENCE ROOM 606	レセプションホール A RECEPTION HALL A	レセプションホール B RECEPTION HALL B	会議室 101 CONFERENCE ROOM 101	セミナー会場A SEMINAR VENUE A	セミナー会場B SEMINAR VENUE B	セミナー会場C SEMINAR VENUE C	パウェル アカデミックフォーラム Power Electronics Next -若手研究者フォーラム- Power Electronics Academic Forum / Power Electronics Next-Early-Career Researchers' Forum	新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～会場① Exhibitor's Product/Technology Seminar / ～New Tech Trend～Venue ①	新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～会場② Exhibitor's Product/Technology Seminar / ～New Tech Trend～Venue ②	中国車 徹底解説セミナー/ 新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～会場③ Seminar for Chinese EVs / Exhibition for New Products / ～New Tech Trend～Venue ③	新製品・新技術セミナー ～New Tech Trend～会場④ Exhibitor's Product/Technology Seminar / ～New Tech Trend～Venue ④	
10:00-11:30 FIW-S4 知能化AIが進むロボットと工場 世界最先端事例から学ぶ Intelligent AI-driven Robots at Factory Learn from the Latest Examples	10:00-10:40 AUTO-EVS1 スズキの技術戦略 ～人と機械に寄り添う～ Smart Technology Strategy for People and the Earth Intelligent AI-driven Robots at Factory Learn from the Latest Examples	10:00-11:10 FIW-S5 次世代オートモーティブ技術～人と機械に寄り添う～ Smart Technology Strategy for People and the Earth Intelligent AI-driven Robots at Factory Learn from the Latest Examples	10:00-11:10 PWB-3 光電子融合が拓く 次世代半導体パッケージ技術の最前線 Frontiers of Next-generation Semiconductor Packaging Driving the Future of AI and IHC with Advanced Packaging and System Innovation	10:00-1:30 ISP-3 AI+IHC時代を切り拓く 先端パッケージ 基礎技術革新 Driving the Future of AI and IHC with Advanced Packaging and System Innovation	10:30-11:20 PDM-F4 パワーデバイスの進化を支える 組合せ偏極化技術による高効率高耐久化 High-performance Power Semiconductor Devices Supporting a High-efficiency and Long-life	11:00-11:30 DAICO-SPKを活用した 次世代SDVソリューション Next-generation SDV solution using Area Laser レーザー発振器	11:00-12:30 小間番号W11-20 1. Opening Speech from Embassy of Israel in Japan 2. Overview of Automotive Ecosystem in Israel by Ministry of Transport 3. C2A Security 4. Foretellix 5. EVR Motors 6. Imagry 7. Valens	11:00-11:30 小間番号W11-21 次世代車載技術の目的的実現 Growth of the Demand for Next-Gen Vehicle Technology	11:00-11:30 小間番号W11-22 DAIKO-SPKを活用した 次世代SDVソリューション Next-generation SDV solution using Area Laser 大規模化	11:00-11:30 小間番号W11-23 1. Opening Speech from Embassy of Israel in Japan 2. Overview of Automotive Ecosystem in Israel by Ministry of Transport 3. C2A Security 4. Foretellix 5. EVR Motors 6. Imagry 7. Valens	11:00-11:30 小間番号W11-24 製造業で使いやすい 高密度収納庫を基盤としたAutoStore事例 Manufacturing Industry knows AutoStore for its productivity	11:00-11:30 小間番号W11-25 製造現場における物流自動化の事例と実践 How Logistics Automation Improves Manufacturing: Cases	11:00-11:30 小間番号W11-26 複雑強化学習・機械学習による ヒューマノイドロボット開発 Complex Reinforcement Learning for Humanoid Robot Development
12:30-13:40 AUTO-AIS1 AI+SDVを搭載する次世代モビリティ: EV2自動運転と車載OSの革新 Next-generation Mobility Driven by AI and SDV Intelligent Driving and In-Vehicle OS	12:30-12:40 FIW-K 製造だからこそできる生産AI活用 ～EV生産から多様化へ、日本の打ち手～ The Critical Role of Generative AI in Manufacturing: Learning from the Latest Use Cases	12:30-14:00 AUTO-CNS2 製造の多様化ゲーム ～EV生産から多様化へ、日本の打ち手～ The Multidimensional Game from EV Domination to Multiplicity Intelligent Manufacturing	12:30-13:40 NEPCON-K 半導体の未来を切り拓く: チップアレンジ技術と複数パッケージが描く AI時代の半導体 Driving the Future of Semiconductors Chip Arrangement Technology and Multi-Package	12:30-14:00 ISP-4 ついに来るか!左、右、中间位置の世界! Shift It! Ready Zone or Left, Right, Middle Position	12:30-14:00 PWB-4 次世代AI+IHCを実現する: 高密度回路形成と 高密度チップアレンジ技術 Radiation-hardened SIC CMOS integrated Circuits and Image Sensors The Key to Next-Gen AI & Photonics High-density Circuit Formation and High-density Chip Arrangement Technology	12:30-14:00 PDM-F5 放熱機能付SIC CMOS回路開発、 イメージング回路と応用展開 Radiation-hardened SIC CMOS Integrated Circuits and Image Sensors Heat Dissipation Function SIC CMOS Circuits Development, Image Sensors Application	13:00-13:30 小間番号E12-21 次世代AIサーバーを支える高密度回路 High-Frequency Copper Pads for Next-Gen AI Servers 粘り合せSIC基板を使った パワーデバイス開発 Developments of Power Device on Advanced SIC-Based Boards	13:00-13:30 小間番号W12-22 パッケージAI: AIモデル基盤と エンジニア型AIワーカー AI Model Base and Engineer Type AI Worker 粘り合せSIC基板を使った パワーデバイス開発 Developments of Power Device on Advanced SIC-Based Boards	13:00-13:30 小間番号W11-78 EMC設計を改善する解析ツール活用～ ～EMIとEMSの開発～ EMC Design Improvement Using Analysis Tools ~ EMI and EMS Development	13:00-13:30 小間番号W11-79 CO2もコストも削減 AI×500万個の需要で決める 省エネの優先順位 CO2 and Cost Reduction AI for 5 million needs Priority Order of Energy Efficiency	13:00-13:30 小間番号S11-14 CO2もコストも削減 AI×500万個の需要で決める 省エネの優先順位 CO2 and Cost Reduction AI for 5 million needs Priority Order of Energy Efficiency	13:00-13:30 小間番号S11-15 深層強化学習・機械学習による ヒューマノイドロボット開発 Complex Reinforcement Learning for Humanoid Robot Development	
13:00-14:00 AUTO-AIS2 SDVを駆使して広がる AI-Defined Vehicleの世界 Beyond SDV: Towards AI-defined Vehicles	13:00-14:00 FOXCONN-B 商談会・交流会 FOXCONN Business Matching & Networking	13:00-17:00 FOXCONN-B 商談会・交流会 FOXCONN Business Matching & Networking	13:00-14:00 NEPCON-K 半導体の未来を切り拓く: チップアレンジ技術と複数パッケージが描く AI時代の半導体 Driving the Future of Semiconductors Chip Arrangement Technology and Multi-Package	13:00-14:00 ISP-4 ついに来るか!左、右、中间位置の世界! Shift It! Ready Zone or Left, Right, Middle Position	13:00-14:00 PWB-4 次世代AI+IHCを実現する: 高密度回路形成と 高密度チップアレンジ技術 Radiation-hardened SIC CMOS integrated Circuits and Image Sensors The Key to Next-Gen AI & Photonics High-density Circuit Formation and High-density Chip Arrangement Technology	13:00-14:00 PDM-F5 放熱機能付SIC CMOS回路開発、 イメージング回路と応用展開 Radiation-hardened SIC CMOS Integrated Circuits and Image Sensors Heat Dissipation Function SIC CMOS Circuits Development, Image Sensors Application	13:00-13:30 小間番号E12-21 次世代AIサーバーを支える高密度回路 High-Frequency Copper Pads for Next-Gen AI Servers 粘り合せSIC基板を使った パワーデバイス開発 Developments of Power Device on Advanced SIC-Based Boards	13:00-13:30 小間番号W12-22 パッケージAI: AIモデル基盤と エンジニア型AIワーカー AI Model Base and Engineer Type AI Worker 粘り合せSIC基板を使った パワーデバイス開発 Developments of Power Device on Advanced SIC-Based Boards	13:00-13:30 小間番号W11-78 EMC設計を改善する解析ツール活用～ ～EMIとEMSの開発～ EMC Design Improvement Using Analysis Tools ~ EMI and EMS Development	13:00-13:30 小間番号W11-79 CO2もコストも削減 AI×500万個の需要で決める 省エネの優先順位 CO2 and Cost Reduction AI for 5 million needs Priority Order of Energy Efficiency	13:00-13:30 小間番号S11-14 CO2もコストも削減 AI×500万個の需要で決める 省エネの優先順位 CO2 and Cost Reduction AI for 5 million needs Priority Order of Energy Efficiency	13:00-13:30 小間番号S11-15 深層強化学習・機械学習による ヒューマノイドロボット開発 Complex Reinforcement Learning for Humanoid Robot Development	
14:00-15:00 AUTO-AIS2 SDVを駆使して広がる AI-Defined Vehicleの世界 Beyond SDV: Towards AI-defined Vehicles	14:00-16:10 SLE-K AI-Defined Vehicleの世界 Beyond SDV: Towards AI-defined Vehicles	14:00-16:10 AUTO-EV3 AI+EV3の パワートレイン技術について A New Era of Talent Acquisition and Profitability Enhancement	14:00-16:10 FIW-56 人を活かし、定義させた組織改革! 組織刷新のためのあり方とは The Future of Organizational Transformation	14:00-16:10 PDM-S1 車載AI+IHCの技術と 電動化の最新技術を徹底討論～ ～電動化の最新技術を徹底討論～ Automotive Power Device Seminar Advanced Power Device Seminar	14:00-16:10 NEPCON-S4 Honda Sリニアの パワートレイン技術について Powertrain Technologies Applied to Honda S Series	14:00-16:10 NEPCON-S5 次世代車載体を捉入する 車載AI+IHCの技術と 電動化の最新技術を徹底討論～ ～電動化の最新技術を徹底討論～ Automotive Power Device Seminar Advanced Power Device Seminar	14:00-16:10 PDM-F6 激変するAI+IHC環境における 新たな競争優位性の必要性 Driving the Need for New Areas of Competitive Advantage Competitive Advantage through Shifting Environments for AI+IHC	14:00-16:10 PDM-F7 パワーエレクトロニクス組立向け 次世代樹脂材料 Strategies for Next-generation Semiconductors Resin Materials for Power Electronics	14:00-16:10 PDM-F8 ボルトグリーン 熱とトルクマネジメント技術 Bolt Green Thermal and Torque Management ボルトグリーン 熱とトルクマネジメント技術 Bolt Green Thermal and Torque Management	14:00-16:10 AUTO-C4 次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場 Hackathon for Next-Gen AI	14:00-16:10 AUTO-C4 次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場 Hackathon for Next-Gen AI	14:00-16:10 AUTO-C4 次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場 Hackathon for Next-Gen AI	
15:00-16:10 AUTO-AIS2 SDVを駆使して広がる AI-Defined Vehicleの世界 Beyond SDV: Towards AI-defined Vehicles	15:00-16:10 SLE-K AI-Defined Vehicleの世界 Beyond SDV: Towards AI-defined Vehicles	15:00-16:10 AUTO-EV3 AI+EV3の パワートレイン技術について A New Era of Talent Acquisition and Profitability Enhancement	15:00-16:10 FIW-56 人を活かし、定義させた組織改革! 組織刷新のためのあり方とは The Future of Organizational Transformation	15:00-16:10 PDM-S1 車載AI+IHCの技術と 電動化の最新技術を徹底討論～ ～電動化の最新技術を徹底討論～ Automotive Power Device Seminar Advanced Power Device Seminar	15:00-16:10 NEPCON-S4 Honda Sリニアの パワートレイン技術について Powertrain Technologies Applied to Honda S Series	15:00-16:10 NEPCON-S5 次世代車載体を捉入する 車載AI+IHCの技術と 電動化の最新技術を徹底討論～ ～電動化の最新技術を徹底討論～ Automotive Power Device Seminar Advanced Power Device Seminar	15:00-16:10 PDM-F6 激変するAI+IHC環境における 新たな競争優位性の必要性 Driving the Need for New Areas of Competitive Advantage Competitive Advantage through Shifting Environments for AI+IHC	15:00-16:10 PDM-F7 パワーエレクトロニクス組立向け 次世代樹脂材料 Strategies for Next-generation Semiconductors Resin Materials for Power Electronics	15:00-16:10 PDM-F8 ボルトグリーン 熱とトルクマネジメント技術 Bolt Green Thermal and Torque Management ボルトグリーン 熱とトルクマネジメント技術 Bolt Green Thermal and Torque Management	15:00-16:10 AUTO-C4 次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場 Hackathon for Next-Gen AI	15:00-16:10 AUTO-C4 次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場 Hackathon for Next-Gen AI	15:00-16:10 AUTO-C4 次世代オートモーティブ生成AIハッカソン 会場 Hackathon for Next-Gen AI	
16:00-17:00	Robert Bosch, Vice President, Dirk Stahl (日本)アドバンスド・ドライブ・テクノロジーズ 日本	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00	16:00-17:00		

会場全体／併催イベント マップ上の番号



1月23日[金]

i. Jan. 23

セミナー・イベント スケジュール Seminar & Event Schedule

※敬称略。セッションの録音、写真・動画撮影などは一切禁止させていただきます。都合により開講プログラムの内容に多少の変更がある場合、およびテキスト配付の無い場合はございません。あらかじめご了承ください。

会議棟			東展示棟							西展示棟							南展示棟		
事前申込制 Pre-registration Required			事前申込制 Pre-registration Required							申込不要 No Application Required							申込不要 No Application Required		
国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL	会議室 606 CONFERENCE ROOM 606	レセプションホール A RECEPTION HALL A	レセプションホール B RECEPTION HALL B	セミナー会場A SEMINAR VENUE A	セミナー会場B SEMINAR VENUE B	セミナー会場C SEMINAR VENUE C	パワエ アカデミックフォーラム Power Electronics Next →New Tech Trend~会場① Power Electronics Academic Forum / Power Electronics Next-Early Career Researchers' Forum	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場② New Product-Tech Seminar / →New Tech Trend-Venue ●	商談室② W-Engineer MeetUP -女性技術者の集い-	車載半導体 フォーラム In-vehicle Semiconductor Forum	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場③ New Product-Tech Seminar / →New Tech Trend-Venue ●	アトリウム 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場④ New Product-Tech Seminar / →New Tech Trend-Venue ●	中国車 徹底解説セミナー/ 新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場⑤ New Product-Tech Seminar / →New Tech Trend-Venue ●	新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~会場⑥ New Product-Tech Seminar / →New Tech Trend-Venue ●	ヒューマノイド ロボットショー Humanoid Robot Show	ST 10			
10:00-11:10 FIW-57 工場と共に働く協働ロボットの今と未来 Collaborative Robots in Factories: The Present and Future	10:00-11:10 SLE-54 グリーン物流最前線 ～モーダルなアプローチで能率改革を描く Green Logistics Frontline ~ Modular Approach to Efficiency Reform	10:00-11:10 AUTO-SDV3 SDV: 産業の革新的変化 SDV: Industry Disruption	10:00-11:10 AUTO-AIS3 AUDIOVIO Xelv ～パートナーシップと共に歩む エンジニアードットの道～ AUDIOVIO Xelv - Full Webinar E3	10:00-11:40 PWB-5 半導体の未来を創る革新技术 加エ-PLP設計の最前線 Innovating the Future of Semiconductors: Advanced PLP Design & System Solutions	10:00-11:30 ISP-5 見えない中身の中へ NEVとSATA交わる「両輪の十字路」 ～車載AIソリューション技術が支える 車載半導体の現状を探る Inside China's Hidden Core: The Crossroads of NEV and SATA Transformation	10:10-11:40 PDM-F7 SiC/パワー半導体デバイス最新技術動向 Latest Technologies Trends in SiC Power Semiconductor Devices	11:00-11:30 小間番号E10-8 基礎技術コーティングの塗布技術と 系連続インバータの属性評価 Dispensing Technologies for PCB Conformal Coating	11:00-11:40 AUTO-F7 次世代AIビリティ実現! SDV向けE/Eアーキテクチャの 進化を加速する半導体ソリューション Realizing Next-generation Mobility Achieving the Evolution of E/E Architecture for SDVs	11:00-11:30 DAIKO-W11-53 DAIKO-SDKを活用した 大丸興業のSDVソリューション DAIKO-SDK Utilization Mitsukoshi SDV Solution	11:00-11:30 MIPI-A-PHY 日本発の次世代自動車コネクティビティ MIPI-A-PHY: Next-Gen Connectivity, with Momentum from Japan Lessons from the Chinese Automotive Industry to the Global Market	11:00-11:30 AUTO-CS 会場番号W11-32 製造業で使い倒す。 高密度収納&高深出のAutoStore®事例 Manufacturing Industry Shows AutoStore® for your productivity	11:00-11:30 小間番号W11-31 製造現場における機械学習による ヒューマノイドロボット開発 Manufacturing Industry Shows Machine Learning for your productivity	11:00-11:30 小間番号S17-40 深層学習による機械学習による ヒューマノイドロボット開発 Machine Learning for your productivity	ST 11					
12:30-13:40 FIW-58 現場から全社へDXへ推進の具体的なステップとは From a Single Team to Company-wide Deployment DXへ推進の具体的なステップとは	12:30-13:40 AUTO-SDV5 SDV時代の協調開発: オープソースが拓く自動車開発の未来 Collaborative Software Development in the SDV Era: Innovation through Open Source	12:30-13:30 AUTO-SDV1 これでSDVの役をもう1回! オーブンソースが拓く自動車開発の未来 The Open Source Project for SDV: What's the Next Step for SDV?	12:30-14:00 AUTO-AIS4 SDVが創る未来のくらしとの接続 ～多様なロボットプレイヤーを交えて～ Future Life Realized by SDV and the Challenges to Achieve it The Future Life Realized by SDV and the Challenges to Achieve it	12:30-13:40 PDM-S2 AI時代を支えるデータセンターと 1MW時代の電力供給 Data Centers for the AI Era and the Power Supply in the 1MW Class	12:30-14:00 PWB-6 加速する先端パッケージの実感、 データセンターそして自動運転へ Advanced Packaging Accelerates to Implement Data Center and Autonomous Driving	12:30-14:00 ISP-6 イン×日本: 半導体バリューチェーンの新時代 India × Japan: New Era in the Semiconductor Value Chain	12:30-14:00 PDM-F8 ダイヤモンドMOSFETの最近の進展 Present State and Prospects of Diamond MOSFETs	13:00-13:30 小間番号E3-8 次世代デバイスの実現に貢献する ディスペンス技術の発展 Disperse Technology for Next-Generation Device Innovation	13:00-13:40 AUTO-F8 SDVを支える 次世代E/Eアーキテクチャの展望 Perspectives on Next-generation E/E Architecture Supporting SDV	13:00-13:30 小間番号E3-52 第3版発行! IEC 61000-4-2 3rd Edition Published! IEC 61000-4-2	13:00-13:30 小間番号W11-79 「EMC設計を効率化できる考え方」 ～ノイズ抑制の視点的解説～ How to Efficiently Optimize EMC Design Approach to Noise Reduction	13:00-13:30 小間番号W11-32 電気施設の総合管理の考え方と スマート保全の動向について Smart Management of Electrical Facilities and the Trend of Smart Maintenance	13:00-13:30 小間番号S17-40 深層学習による機械学習による ヒューマノイドロボット開発 Machine Learning for your productivity	ST 12					
15:00-16:30 AUTO-SDV4 SDV時代の車両アーキテクチャ: 統合ECUとE/E最新トレンド Vehicle Architecture in the SDV Era: Integrated ECU and E/E Latest Trends	15:00-16:10 FIW-59 製造現場におけるエアブル半導体デバイス活用 Case Studies Utilizing Airable Devices in Manufacturing	15:00-15:50 AUTO-EV4 ICEで走れる走るほど大容量をきれいにする! ～EV技術との連携開発～ ICE Driven by EV Technology	15:00-15:50 PDM-53 パワー半導体デバイス ～車載化の実現と活用の新たな可能性～ Power Semiconductor Devices →New Tech Trend-Electronic Applications Opportunity	15:00-16:10 NEPCON-56 富士NEXT開催! HPC/次世代アーキテクチャの詳細に迫る ～車載用HPCとその開発技術～ →HPC and Next-Generation Architecture for Automotive Applications	15:00-16:10 NEPCON-56 富士NEXT開催! HPC/次世代アーキテクチャの詳細に迫る ～車載用HPCとその開発技術～ →HPC and Next-Generation Architecture for Automotive Applications	15:00-15:30 小間番号E5-21 ロールプレス・熱圧着の圧力定量化による 品質改善・歩留り向上 Surface Pressure Quantification for Improving Product Quality	14:00-15:30 小間番号E7-12 SIXセミナー: EMS×材料で切り拓く次世代リユース SIX Seminar: Non-Green Value Chain through EMS & Materials	14:00-14:40 WEMUP-52 立ち止まりながら考えて。 女性技術者のスキルアップとキャリア形成 ※講演終了後、カジュアルな交流会を実施!	14:00-14:40 AUTO-F9 オートモーティブ 超音波センシング技術の革新 Innovations in Automotive Ultrasonic Sensing	14:00-14:30 小間番号W6-32 高信頼性実装を実現する はんんだ材料の新動向 High Reliability Packaging Realization New Trend of Handa Materials	14:00-14:30 小間番号W13-92 中国自動車メーカーに学ぶ能力 ～技術革新・スピード・コスト優位性～ Lessons from Chinese Automakers Technology Innovation, Speed, Cost Efficiency	14:00-14:30 小間番号W13-92 人と一緒に働くヒューマノイド "NEXTAGE"が拓く新しい働き方 People Working Together with Humanoid Robots "NEXTAGE" Opens Up a New Way of Working	ST 13						
ST 14	ST 15	ST 16	ST 17	ST 18	ST 19	ST 20	ST 21	ST 22	ST 23	ST 24	ST 25	ST 26	ST 27	ST 28	ST 29	ST 30	ST 31	ST 32	